

复旦大学有源硅中介层芯片封装加工服务延期公告

(招标编号: FW2026090901)

一、内容:

更正事项:采购公告

更正内容:

1、招标文件的获取截止时间延期至:2026 年 10 月 8 日 17:00 时。

2、开标和投标截止时间延期至:2026 年 10 月 19 日 09:30 时。

其余内容不变。

已获取招标文件的供应商须登录复旦大学采购与招标管理系统(网址为:<https://cz.fudan.edu.cn>)下载更新的招标文件,并将招标文件重新导入复旦大学采购与招标管理系统的投标文件编制工具后制作投标文件。未重新下载招标文件并将招标文件导入投标文件编制工具后制作的投标文件将无法在复旦大学采购与招标管理系统中提交,其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

延期开标: 2026-10-19 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为财政部门。

三、联系方式

招 标 人: 复旦大学

地 址: 中国上海邯郸路 220 号

联 系 人: 李老师

电 话: 021-65641327

电子邮件: /

招标代理机构: 上海政采项目管理有限公司

地 址: 上海市静安区天目中路 380 号 11 楼

联 系 人: 王一澄、孙健峰

电 话: 021-62091273*8003

电子邮件: wangyicheng@shzfcg.cn

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王-隆（签名）

招标人或其招标代理机构（盖章）

